

2025年7月30日

各位

インスペック株式会社
代表取締役 菅原 雅史

新製品のリリースに関するお知らせ

当社は、AI市場の急成長に伴い急速に進展する半導体パッケージ基板のチップレット化^{※1}及び微細配線化に対応すべく、次世代半導体パッケージ基板検査装置『SX7000』シリーズ及びレーザーリペア装置『LX7000』の開発を完了し、このたび受注を開始することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 次世代半導体パッケージ基板の市場ニーズ

生成AIの急速な普及を背景に、AI向けデータセンターへの投資が世界規模で拡大しております。これに伴い、複数のチップを単一のパッケージ上で接続するチップレット技術の導入が進み、半導体パッケージ基板の重要性が一層高まっております。

更に、高密度実装を可能にするインターポーザー^{※2}の需要も増加しており、半導体パッケージ基板には、一段と高度な微細化と高密度化が求められております。これにより、検査装置に対しても、より高精度かつ高性能な検査能力が不可欠となっております。

こうした市場ニーズに対応すべく、当社は次世代半導体パッケージ基板検査装置『SX7000』シリーズ及びレーザーリペア装置『LX7000』の開発を進めてまいりました。

※1：チップレット化

従来1枚の大きなシリコン上に集積していた回路を、機能ごとに分割した複数の小型チップとして製造し、パッケージ内で高速接続する技術。これにより異なる製造プロセスの組み合わせや歩留まり向上が可能となり、性能向上とコスト低減を両立できる。AI向け高性能プロセッサなどで採用が拡大している。

※2：インターポーザー

複数のチップレットを高密度で接続するための中間基板で、シリコンや有機材料で構成される。微細配線を多数形成できるため、高速信号伝送や電源供給の効率化が可能。特にAI向け高性能半導体パッケージで、GPUやメモリ間の接続に用いられ、チップレット技術を支える重要な役割を担っている。

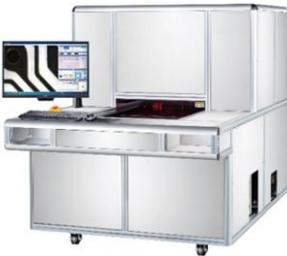
2. 新製品の特徴と市場への貢献

『SX7000』シリーズは、最小ライン&スペース $2.0\mu\text{m}\sim 1.5\mu\text{m}$ という次世代高精細基板の検査に対応した、最新の半導体パッケージ基板検査装置です。AIサーバー向けパッケージ基板における配線パターンの微細化・高密度化が進む中、当社が長年にわたり蓄積してきたハイエンドパッケージ基板向けAOI技術と経験を結集し、従来スペックを大幅に上回る高精度な検査を実現いたしました。

更に今回、同様に微細パターンに対応したレーザーリペア装置『LX7000』も併せてリリースいたします。検査からリペアまで一貫したソリューションを提供することで、お客様の生産効率向上と歩留まり改善に貢献してまいります。

これにより、生成 AI やデータセンター市場の拡大とともに高度化する半導体パッケージ基板製造現場の多様なニーズに対応してまいります。

3. 新製品の概要

| 装置名称 | 次世代半導体パッケージ 基板検査装置 | レーザーリペア装置 |
|---------|---|--|
| モデル | SX7300/SX7400 | LX7000 |
| 外観イメージ |  |  |
| 最小 L/S* | 2.0 μm/2.0 μm / 1.5 μm/1.5 μm | 2 μm/2 μm |
| 基板サイズ | 615mm x 515mm | 615mm x 515mm |
| 外形 | W:1, 590mm×D:2, 450mm×H:2, 255mm | W:1, 935mm×D:2, 100mm×H:2, 275mm |
| 重量 | 約 2,800kg | 約 2,500kg |

※ L/S (Line and Space) : 配線の線幅とその間隔のこと

4. 今後の見通し

当該新製品につきましては、受注から検収までにおおよそ1年程度を要する見込みであることから、2025年6月13日に公表した2026年4月期の業績予想には織り込んでおらず、当期業績への影響は軽微と見込んでおります。今後の受注状況を慎重に見極めつつ、必要に応じて適宜開示してまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

インスペック株式会社 管理部 IR 担当

Email:inspec.info@inspec21.com TEL:0187-54-1888